

Title (en)
Sealing method of a high frequency cable connecting element

Title (de)
Verfahren zum feuchtigkeitsdichten Anbringen eines Verbindungselements an einem Hochfrequenzkabel

Title (fr)
Méthode d'étanchéification d'un élément de connexion sur un câble haute fréquence

Publication
EP 0849838 A2 19980624 (DE)

Application
EP 97402822 A 19971125

Priority
DE 19654012 A 19961221

Abstract (en)
The fixing method is used for attaching a connection element (3) to the end of a HF cable (1), with a humidity-tight seal between the connection element and the cable provided by a sealing material (15) between a metal contact (11,12) and the cable conductor (7) and between the contact and the cable insulation mantle (10). A dual-component sealing material is used, its volume increased after assembly of the metal contact, for filling the hollow spaces between the contact and the cable conductor and between the contact and the cable insulation mantle.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zum feuchtigkeitsdichten Anbringen eines Verbindungselements (3) an einem Hochfrequenzkabel (1) angegeben, das zumindest einen rohrförmigen elektrischen Leiter (7) aufweist, der von einem aus Isoliermaterial bestehenden Mantel (10) umgeben ist. Dabei wird zunächst das Ende des Leiters (7) vom Mantel (10) befreit. Danach wird ein buchsenförmiges, metallisches Kontaktteil an diesem Ende des Leiters (7) elektrisch festgelegt. Zwischen Kontaktteil und Leiter (7) einerseits sowie Kontaktteil und Mantel (10) andererseits ist ein abdichtendes Material angebracht. Als abdichtendes Material wird ein aus mindestens zwei Komponenten bestehendes Dichtmaterial (15) verwendet, das nach Montage des Kontaktteils (11,12) sein Volumen derart vergrößert, daß der umlaufende Hohlraum zwischen Kontaktteil (11,12) und Leiter (7) sowie zwischen Kontaktteil (11,12) und Mantel (10) zumindest im Übergangsbereich vom Leiter (7) zum Mantel (10) durch dasselbe ausgefüllt wird. <IMAGE>

IPC 1-7
H01R 13/52; **H01R 9/05**

IPC 8 full level
H01R 24/38 (2011.01); **H01R 9/05** (2006.01); **H01R 13/52** (2006.01); **H02G 1/14** (2006.01); **H02G 15/04** (2006.01)

CPC (source: EP US)
H01R 9/0521 (2013.01 - EP US); **H01R 13/5205** (2013.01 - EP US); **H01R 13/5216** (2013.01 - EP US); **H01R 24/566** (2013.01 - EP); **Y10T 29/49123** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/49176** (2015.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)
BE CH DE DK FI FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0849838 A2 19980624; **EP 0849838 A3 19990818**; **EP 0849838 B1 20020522**; AU 4839297 A 19980625; AU 730306 B2 20010301; BR 9706381 A 19990302; CN 1192599 A 19980909; DE 19654012 A1 19980702; DE 19654012 C2 19990812; DE 59707323 D1 20020627; JP H10223305 A 19980821; KR 19980064445 A 19981007; RU 2144251 C1 20000110; US 6148513 A 20001121

DOCDB simple family (application)
EP 97402822 A 19971125; AU 4839297 A 19971215; BR 9706381 A 19971217; CN 97108742 A 19971219; DE 19654012 A 19961221; DE 59707323 T 19971125; JP 35139597 A 19971219; KR 19970071337 A 19971220; RU 97122266 A 19971219; US 99485797 A 19971219